

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Dezember 2003 (24.12.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/107550 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04B 1/38

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE03/01968

(22) Internationales Anmeldedatum:
6. Juni 2003 (06.06.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 27 413.4 14. Juni 2002 (14.06.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ENDERLEIN,
Janos-Gerold [DE/DE]; Hannoversche Str. 22, 10115

Berlin (DE). DUCHSTEIN, Henrik [DE/DE]; Strawin-
skyst. 12, 13158 Berlin (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

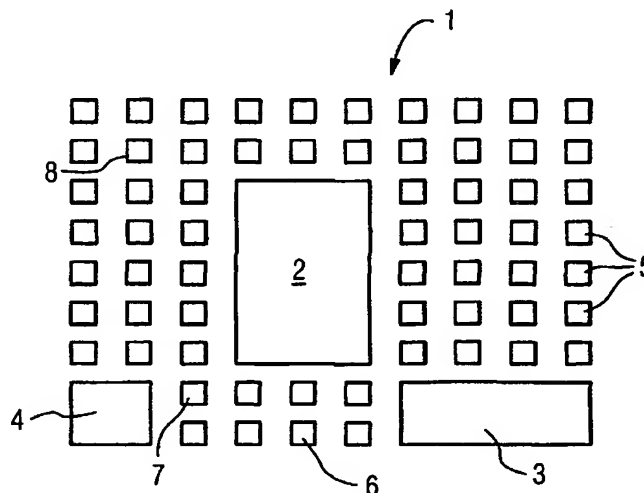
Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die fol-
genden Bestimmungsstaaten CN, JP, europäisches Patent
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CONTACTING AT LEAST ONE MODULE FOR A WIRELESS RADIO STANDARD BY MEANS
OF AT LEAST ONE APPLICATION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR KONTAKTIERUNG MINDESTENS EINES MODULS FÜR DRAHTLOSE
FUNKSTANDARDS MIT MINDESTENS EINER APPLIKATION



(57) Abstract: The invention relates to a method for contacting at least one module for a wireless radio standard by means of at least one application, according to which one side of the module, which is to be contacted by means of the application, is provided with contact surfaces while one side of the application, which is to be contacted by means of the module, is provided with contact surfaces that are able to interact with the contact surfaces of the module, and a connection is established between the respective contact surfaces of the module and the application. The invention also relates to a combination of a module for wireless radio standards and an application. One side of said module, which is to be contacted by means of the application, comprises contact surfaces (planar contact elements) while one side of the application, which is to be contacted by means of the module, comprises contact surfaces that can interact with the contact surfaces of the module and can be contacted by said contact surfaces of the module.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 03/107550 A1